

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第3区分

【発行日】平成28年2月12日(2016.2.12)

【公開番号】特開2014-122274(P2014-122274A)

【公開日】平成26年7月3日(2014.7.3)

【年通号数】公開・登録公報2014-035

【出願番号】特願2012-279137(P2012-279137)

【国際特許分類】

C 08 L 83/04 (2006.01)

C 08 K 3/16 (2006.01)

H 01 L 33/56 (2010.01)

【F I】

C 08 L 83/04

C 08 K 3/16

H 01 L 33/00 4 2 4

【手続補正書】

【提出日】平成27年12月11日(2015.12.11)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

シリコーン樹脂、蛍光体および無機粒子を含むシリコーン樹脂組成物であって、前記無機粒子の密度が4.5g/cm<sup>3</sup>以上4.9g/cm<sup>3</sup>以下であり、前記無機粒子の屈折率が1.45以上1.47以下であることを特徴とするシリコーン樹脂組成物。

【請求項2】

前記無機粒子がフッ化バリウムである請求項1記載のシリコーン樹脂組成物。

【請求項3】

組成物における前記無機粒子の固形分濃度が0.5v01%以上である請求項1記載のシリコーン樹脂組成物。

【請求項4】

発光ダイオード用に用いられる請求項1～3のいずれかに記載のシリコーン樹脂組成物。

【請求項5】

請求項1～3のいずれかに記載のシリコーン樹脂組成物の硬化物。

【請求項6】

請求項1～3のいずれかに記載のシリコーン樹脂組成物の硬化物を備える発光ダイオード。

【請求項7】

請求項1～3のいずれかに記載のシリコーン樹脂組成物をLEDチップ上にディスペンス法で膜形成した後、硬化させる工程を含む発光ダイオードの製造方法。